## インターンシップ合同説明会

参加企業: 京セラ株式会社、株式会社日立製作所、株式会社東芝、高砂熱学工業 株式会社

開催日時:令和6年5月14日(火) 15:00~18:00 工学部B31講義室 ハイブリッド形式で開催しますが、第一部、第二部は原則対面で行います ZOOM ID 813 8736 0670 パス 787476

第一部 15:00~15:40 京セラ株式会社 対面で実施します。

2024 年度研究インターンシップ説明会 概要説明 (全体で 40 分程度)

京セラ概要と研究インターンシップについて

受入部門の概要説明

第二部 15:50~16:30 株式会社日立製作所 対面で実施します。

2024 年度研究インターンシップ説明会 概要説明 (全体で 40 分程度)

日立製作所概要と研究インターンシップについて

受入部門の概要説明

第三部 16:40~17:10 株式会社東芝 オンラインで実施します。

2024 年度研究インターンシップ説明会 概要説明 (全体で 40 分程度)

東芝概要と研究インターンシップについて

受入部門、受入テーマの概要

申込方法のご説明

第四部 17:20~18:00 高砂熱学工業株式会社 オンラインで実施します。

2024 年度研究インターンシップ説明会 概要説明 (全体で 40 分程度)

高砂熱学工業概要と研究インターンシップについて

受入部門の概要説明

## 個別説明会

京セラ株式会社: 15:00~18:30 場所:L200

株式会社日立製作所:15:00~18:00 場所:A3-71

株式会社東芝: 15:30~18:00 Z00M ブレイクアウトルーム「東芝控室」に参加

高砂熱学工業: 15:30~ ZOOM ブレイクアウトルーム「高砂控室」に参加

備考:自由参加でいつでも退室可能。ただし、資料の準備もあるので、下記の連絡先にメ

ールをもらえると助かります。

【連絡先】北海道大学大学院工学研究院 工学系教育研究センター(CEED) 事務室

Tel 011-706-7163 e-mail : ceed-ind@eng.hokudai.ac.jp

(主催) 工学系教育研究センター(CEED)